

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（ ）
参与单位名称	<u>2024年7月2日</u> 国盛资本、国投聚力、华泰资产管理、易米基金、比亚迪股份有限公司、石丸梨花私募基金、上海国鑫投资、上海复星高科技集团等 <u>2024年7月2日</u> 博时基金、长江养老保险、国泰基金、泓德基金、汇丰晋信、嘉实基金、农银汇理基金、鹏华基金、中信保诚基金等 <u>2024年7月3日</u> D. E. Shaw Investment Management、Magellan Capital、Manulife Investment Management、Orchid Asia Group Management、Principal Asset Management、淡马锡投资、景林资产等
时间	2024年7月2日，2024年7月3日
调研方式	线上及线下会议
公司接待人员姓名	公司董事长兼总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民）

	<p>公司董事、CFO、董事会秘书：施文茜</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	
<p>公司介绍</p>	<p>芯原股份是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。公司至今已拥有高清视频、高清音频及语音、车载娱乐系统处理器、视频监控、物联网连接、数据中心等多种一站式芯片定制解决方案，以及自主可控的图形处理器 IP、神经网络处理器 IP、视频处理器 IP、数字信号处理器 IP、图像信号处理器 IP 和显示处理器 IP 共六类处理器 IP、1,500 多个数模混合 IP 和射频 IP。主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括 IDM、芯片设计公司，以及系统厂商、大型互联网公司。</p> <p>芯原在传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有 14nm/10nm/7nm FinFET 和 28nm/22nm FD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验，目前已实现 5nm 系统芯片（SoC）一次流片成功，多个 5nm 一站式服务项目正在执行。根据 IPnest 的统计，从半导体 IP 销售收入角度来看，芯原连续多年排名中国第一、全球第七，在全球排名前七的企业中，芯原的 IP 种类排名前二。</p> <p>2024 年上半年，半导体产业逐步复苏，下游客户库存情况已明显改善，得益于公司独特的商业模式，即原则上无产品库存的风险，无应用领域的边界，以及逆产业周期的属性，公司经营情况快速扭转，业务逐步转好，第二季度业绩较第一季度显著改善。公司持续开拓增量市场和具有发展潜力的新兴市场，拓展行业头部客户，新签订单情况良好，在手订单已连续三季度保持高位。2024 年第二季度起，公司在手订单大量转化为收入，预计 2024 年第二季度单季度实现营业收入 6.10 亿元，较一季度环比增长 91.87%。</p> <p>公司 2024 年第二季度财务数据为初步核算数据，具体准确的财务数</p>

	<p>据以公司正式披露的 2024 年半年度报告为准。</p>
<p>交流问答</p>	<p>问题：公司二季度收入环比增长较多，请问公司如何看待未来业绩趋势？</p> <p>回复：2024 年上半年，半导体产业逐步复苏，下游客户库存情况已明显改善，得益于公司独特的商业模式，即原则上无产品库存的风险，无应用领域的边界，以及逆产业周期的属性，公司经营情况快速扭转，业务逐步转好，第二季度业绩较第一季度显著改善，公司预计 2024 年第二季度单季度实现营业收入 6.10 亿元，较一季度环比增长 91.87%。</p> <p>公司持续开拓增量市场和具有发展潜力的新兴市场，拓展行业头部客户。在 2023 年末，公司在手订单金额达 20.61 亿元；在今年第一季度末，在手订单金额进一步提升至 22.88 亿元；公司第二季度新签订单情况良好，在手订单保持高位，为未来收入增长奠定基础。</p> <p>问题：请问公司如何展望未来境内外收入占比情况？</p> <p>回复：近年来，国内市场对于半导体 IP 和芯片的需求较为旺盛，公司境内销售收入提升较快，在 2023 年度，公司境内销售收入 18.07 亿元，同比增长 3.85%，占营业收入比重为 77.28%，较去年同期的 64.94% 大幅提升；受到海外宏观经济等因素影响，公司境外销售收入 5.31 亿元，同比有所下滑，境外收入占整体营业收入比重为 22.72%。根据目前订单情况，在 2024 年，公司海外客户需求有所恢复。公司始终重视扩充海内外客户资源，关注全球市场机遇，实现境内外业务同步发展。</p> <p>问题：近期端侧 AI 场景如 AI PC、AI 手机等应用需求增长，请问公司在相关领域有哪些技术布局？</p>

回复：近年来，边缘人工智能应用快速发展，公司不断优化升级相关 IP 技术，提升公司自身的竞争力和市场地位。目前，芯原神经网络处理器 NPU IP 已被 72 家客户用于上述市场领域的 128 款 AI 芯片中，集成了芯原 NPU IP 的人工智能（AI）类芯片已在全球范围内出货超过 1 亿颗，主要应用于包含智能手机、平板电脑、可穿戴设备等在内的 10 多个市场领域。为应对手机、电脑对 AI 算力持续增长的需求，公司一直以来持续优化和升级公司的 NPU IP，并推出了一系列创新的 AI-ISP、AI-GPU 等基于公司 NPU 技术的 IP 子系统，给传统的处理器技术带来颠覆性的性能提升，为各类终端电子产品提供多维度、高效率的人工智能升级。公司始终关注市场趋势和技术发展动向，积极推进新技术的研发，基于自身半导体 IP、芯片定制硬件、软件平台的技术赋能能力，持续提升公司在相关领域中的地位与价值。

问题： 请问公司在 Chiplet 领域的研发布局和客户合作情况有哪些进展？

回复：芯原拥有丰富的处理器 IP，以及领先的芯片设计能力，加上我们与全球主流的封装测试厂商、芯片制造厂商都建立了长久的合作关系，近几年来一直在致力于 Chiplet 技术和产业的推进，通过“IP 芯片化，IP as a Chiplet”和“芯片平台化，Chiplet as a Platform”，来促进 Chiplet 的产业化。Chiplet 技术将提高公司的 IP 复用性，增强业务间协同，增加设计服务的附加值，拓宽业务市场空间；进一步降低客户的设计时间、成本和风险，提高芯原的服务质量和效率，更深度绑定客户；并进一步提高公司盈利能力，实现竞争力升维，将芯原的 IP 授权业务和一站式芯片定制服务业务推上新的高度。

公司根据具体应用需求，正在持续推进关键功能模块 Chiplet、Die-to-Die 接口、Chiplet 芯片架构、先进封装技术的研发工作。同时，芯原还将进一步迭代并推广采用 Chiplet 架构所设计的高端应用处理器平台。此外，公司还基于自有的通用图形处理器（GPGPU）IP、NPU IP、UCIe 物理层

(PHY) 等技术, 正在积极推进面向 AIGC 和汽车高级驾驶辅助系统 (ADAS) 应用、采用 Chiplet 架构的芯片设计平台的研发。

在 2023 年, 芯原已经和客户开展合作, 为其提供包括 GPGPU、NPU 和 VPU 在内的多款自有处理器 IP, 帮助客户部署基于 Chiplet 架构的高性能人工智能芯片, 该芯片面向数据中心、高性能计算、汽车等应用领域。

问题: 请问公司目前再融资计划的进度如何?

回复: 公司计划向特定对象发行 A 股股票, 募集资金总金额不超过 180,815.69 万元 (含本数), 计划投向 AIGC 及智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发项目和面向 AIGC、图形处理等场景的新一代 IP 研发及产业化项目。公司已于 2024 年 5 月 29 日披露了《关于芯原微电子 (上海) 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 (修订版)》, 公司正积极推进相关事项, 后续受理或取得新的审核进展, 公司将根据相关法规及时履行信息披露义务。